

## Reparación de Notebooks, Netbooks, Ultrabooks, Tablets y All in Ones.

**Método:** Capacitación Práctica Presencial

**Nivel:** Técnico (Nivel 2)

**Modalidad:** Intensiva

### Introducción y aclaraciones:

- **Las capacitaciones presenciales son 100% prácticas.**  
Por ello es requisito indispensable haber estudiado y tener adquiridos los conocimientos teóricos que corresponden al nivel que va a cursar (La teoría se encuentra a su disposición en nuestra web de manera libre y gratuita en formato PDF).
- **Saque el mayor provecho a su inversión.**  
Si concurre sin haber estudiado debidamente la teoría estará desperdiciando una posibilidad única, que no le podrá brindar ningún otro instituto, (La posibilidad de aprender a reparar equipos portátiles con todos los materiales, maquinarias, herramientas y elementos que podría soñar tener en su laboratorio o taller).
- **Los instructores lo guiarán constantemente.**  
Durante el desarrollo de la capacitación los instructores lo asistirán en todo momento al aplicar la teoría para que Ud. pueda sacar el mayor provecho posible y logre los objetivos principales de esta capacitación.

### Principales objetivos de esta capacitación:

- Diagnosticar todas las fallas que puedan presentarse en un mother de Notebook o Netbook.
- Reparar a nivel electrónico un amplio universo de fallas que puedan presentarse en un mother de Notebook o Netbook.
- Conocer un panorama de características y costos de las herramientas necesarias.
- Trabajar con estaciones de soldado IR y de aire caliente bajo la supervisión de los instructores.
- Aplicar metodologías profesionales en nuestra labor técnica.

- Identificar componentes, sus características básicas y sus posibles fallas.
- Introducción a la electrónica.
- Herramientas y uso de tester.
- Interpretar esquemas y hojas de datos técnicas.

## Temario Capacitación Práctica Presencial:

- 1. Práctica: Diagnóstico y reparación de fallas en componentes BGA:**
  - a. El alumno podrá distinguir fallas en componentes BGA en motherboards y solucionar la problemática.
- 2. Práctica: Realización de desoldado y soldado de componentes BGA:**
  - a. El alumno realizará practicas de desoldado y soldado de chipsets con soldadoras BGA por infrarrojo bajo la supervisión de los instructores.
- 3. Práctica: Realización de Reballing:**
  - a. El alumno realizará reballing (reembolillado de chipset) con soldadoras de aire caliente y lápiz bajo la supervisión de los instructores.
- 4. Práctica: Correcto manejo de la técnicas de soldado BGA:**
  - a. El alumno podrá comprender a través de la curva de fusión del estaño la técnica de soldado BGA.
- 5. Práctica: Introducción a la electrónica:**
  - a. Identificar componentes, sus características básicas y sus posibles fallas.
  - b. Medición de componentes electrónicos.
- 6. Práctica: Diagrama en bloques de un motherboard:**
  - a. Entender como se relacionan los principales componentes de un motherboard a través de un diagrama en bloques aplicado a un mother real.
- 7. Práctica: Hojas de datos de componentes electrónicos:**
  - a. Interpretar la función y disposición de terminales de un componente electrónico para su correcta medición.
- 8. Práctica: El uso del tester**
  - a. Desarrollar el uso del tester en mediciones pasivas y activas.
- 9. Práctica: Correcto manejo de técnicas de soldado THT y SMT:**
  - a. El alumno podrá comprender a través practicas las técnicas de soldado THT y SMT.
- 10. Práctica: BIOS:**
  - a. Análisis del BIOS, sus fallas y práctica de regrabado del mismo.